

深圳市景旺电子股份有限公司

2018年度总经理工作报告

2018年，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）管理层在董事会的带领下，紧密围绕着“以人为本、制造精品、拓展企业、回报社会”的经营理念，专业专注，对外积极开拓市场，对内不断提高管理水平和生产能力，圆满完成了公司的年度经营目标，确保公司的稳健快速发展，有序推进公司长期战略目标的落地。现在就公司管理层在2018年度（以下简称“报告期”）的工作汇报如下：

一、2018 年度主要经营指标

2018 年，公司实现营业总收入 498,555.91 万元，比上年同期增长 18.93%；归属于上市公司股东的净利润 80,265.87 万元，比上年同期增长 21.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 75,052.33 万元，比上年同期增长 19.05%；经营活动产生的现金流量净额 80,383.96 万元，比上年同期增长 10.33%。

截至 2018 年底，公司资产总额 767,010.95 万元，同比增长 60.55%；归属于上市公司股东的所有者权益合计 414,302.95 万元，同比增长 26.45%。

报告期内，公司实现营业收入、净利润等经营指标的稳步增长，离不开公司各部门、各员工践行公司经营理念的专业专注、勤勉尽责。正是每一位成员的辛勤付出，确保了江西二期项目建设工作有效推进、新产能有序释放、FPC 事业群生产效率良率大幅提升、企业基础管理能力持续提升等工作目标的圆满达成。

报告期内主要经营数据和财务指标：

项目	2018 年	2017 年	变动幅度
营业收入（万元）	498,555.91	419,201.78	18.93%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	80,265.87	65,973.51	21.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	75,052.33	63,044.44	19.05%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	80,383.96	72,855.67	10.33%
基本每股收益（元/股）	1.97	1.62	21.60%

加权平均净资产收益率	21.97	21.50	1.13%
项目	2018 年末	2017 年末	变动幅度
资产总额（万元）	767,010.95	477,739.66	60.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	414,302.95	327,643.80	26.45%

二、2018 年主要工作内容

根据IMF统计，2018年全球GDP增长率为3.7%，相比于2017年略微上升0.1%，中国GDP增长处于领先地位，保持着6.6%的较高增长率。2018年全球电子行业仍保持着5.5%的强劲增长率，这一年是电子行业的转型中期，电子行业的关键驱动力正在发生根本性改变，带动了PCB市场的新一轮增长。印制电路板是电子产品的关键电子互连件，作为所有电子产品不可或缺的组件，是电子行业发展之基础。根据Prismark统计，2018年，全球PCB产值为623.96亿美元，同比增长6.0%，中国大陆PCB产值高达327.02亿美元，同比增长10.0%，位列全球各区域增长率之首。

依托于完整的产业链，全球PCB制造向中国大陆转移的趋势仍在加深，中国大陆PCB行业集中度不断提升，已经进入行业结构性调整的关键时期。公司刚性电路板、柔性电路板两大类产品并驾齐驱、稳步发展，公司各产品广泛应用于通讯设备、汽车电子、工控医疗、消费电子等领域，在技术、客户、管理等多个方面具备独到优势。报告期内，公司上下一心，目标一致，通过积极开拓市场、加强技术创新、不断提高管理水平，增强公司的综合竞争力；通过顺应行业发展趋势，抓住机遇，实现企业的长期可持续发展。

（一）以客户为中心、品质优先，积极开拓市场，稳步提高产销量

报告期内，公司 PCB、FPC 两大业务齐头并进，坚持以客户为中心的原则、深入贯彻品质优先的管理理念，积极开拓市场，不断加深与国内外新老客户的合作。公司各事业部，结合各自工厂差异化特点与所服务的具体客户，在产品转型、技术改造、精益生产等方面重点开展工作，产能和效率显著提升，内部基础管理水平大幅度提升，有效降低报废和生产成本。本年度，公司实现 RPCB 营业收入 29.86 亿元，比上年同期增长 21%；FPC 营业收入 15 亿元，比上年同期增长 14%；MPCB 营业收入 4.25 亿元，上年同期增长 25%。公司 RPCB、MPCB 产品保持着 98%以上的综合良率，公司 FPC 产品达到了 96%以上的综合良率，相比较上一年

度提高 3 个百分点，效益提升明显。

（二）紧跟行业发展趋势，面向未来储备丰富的技术

随着电子产品日趋小型化、轻薄化，对功能的安全性、质量的稳定性和一致性要求更高，PCB 产品逐步向高密度、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展。为保持公司产品的持续竞争力，公司管理层应市场发展，积极推动开展技术研发活动，面向未来，储备技术。报告期内，公司研发投入 23,114.05 万元，相较 2017 年度增长 16.24%，大力开展了 5G 相关的 PTFE、LCP 等材料加工技术、多层软板盲孔技术、无线充电及新能源产品制作技术、多层刚挠结合板制作技术、铝基板电镀技术开发、含有盲孔及精细线路的铜基板技术开发等技术研发项目。

报告期内，公司取得了一系列的知识产权成果，新增发明专利合计 34 件，新增实用型专利 32 件、新增著作权 1 件。除取得发明专利和实用新型专利外，公司还自主开发了多项非专利技术，提升生产工艺水平，增强产品竞争力。公司“高密度多层柔性板技术”、“高精度指纹识别柔性板技术”、“多阶 HDI 印制板技术”、“嵌埋铜块技术”、“24G/77G 汽车雷达微波板”、“5G 天线产品技术”等已具备量产能力。报告期内，公司“高密度多层板”、“高密度互联高多层刚挠结合板”、“COB 封装金属基板”、“绝缘槽铜基板”4 个产品认定为高新技术产品证书，公司荣获“中国机械工业科学技术奖”、“广东省科学进步奖”等奖项。

（三）加快智能化工厂建设，大力提升企业智能制造水平

报告期内，公司重点投资的“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）”进展顺利，本项目实现了生产的全流程自动化及可靠性追踪、中央系统实时检测并调控的智能化功能。报告期内，公司管理层按照既定计划，积极推进智能化工厂的建设，项目广泛使用 AGV 小车、机械臂等代替人工，实现企业云计算和自动化设备的网络互联，逐步优化大数据应用功能模块，自主培养首批智能化工厂管理团队。项目自上半年投产以来，管理团队不断的实践、总结、优化，江西二期在效率、成本、可靠性追溯、交期等方面表现突出，报告期内已投产的三条产线产能爬坡顺利，预计全部建成达产后，公司可以为客户提供更多高质量产品。

（四）持续优化管理手段，实现信息化、数字化价值转型

公司一直以来非常重视信息化管理，通过不断引入、优化信息化管理系统，提升企业管理手段，提高管理的及时性、准确性、科学性。2015年，公司引进“甲骨文(Oracle)”ERP系统,开启了公司信息化和工业化一体管理体系的运用，实现了对生产全流程的信息化处理。报告期内，公司管理层通过“三化委员会”，推动公司深入开展信息化管理工作。同时，公司通过开展EHR、SRM、EDI、一卡通等专项项目，有序推进内部员工、供应商、客户订单等方面的信息化、智能化管理，逐步搭建企业内外部信息化管理的“完整链条”，使得公司整体基础管理水平得到长足的进步。公司持续加强信息化、自动化和智能化管理工作，既可以实现企业资源配置的最大化，还能实现信息化、数字化的价值转型，用精准的数据、有效的分析，支持业务发展，为公司决策提供依据。

(五) 完成再融资、股权激励、投资并购，助力企业长远发展

2018年7月，公司完成了可转换公司债券的公开发行并上市，募集资金9.78亿元，解决了江西二期项目的投资资金需求问题，同时也为公司后续发展夯实了资金基础。江西二期项目的顺利开展，解决了公司PCB产能不足与订单较满之间的矛盾，提升了公司的管理水平和产能质量，增强了公司为客户创造更多价值的的能力。

2018年11月，公司实施了上市后的首次股权激励计划，向公司的核心管理人员、核心技术（业务）人员授予了限制性股票。建立健全公司长期有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和留住优秀人才和业务（技术）骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发展。

2018年12月，公司完成并购标的珠海景旺柔性电路有限公司(更名前为“珠海双赢柔软电路有限公司”)的股权交割工作，为有序开展对并购标的的管理工作，公司迅速组建管理团队、“因地制宜”制定管理方案，并有序推进方案的落地。此次投资并购，解决了公司FPC产能紧缺与订单之间的矛盾，同时丰富了公司FPC产品类型，有利于公司实现FPC产品结构调整、提高综合竞争力并扩大市场占有率。

三、2019 年公司主要工作重点

根据Prismark预测，2019年全球PCB产值预计637亿美元，中国大陆PCB产值

预计337亿美元，占全球产值的52.9%；2018-2022年，全球PCB产值复合增长率为3.7%，中国大陆PCB产值复合增长率为4.4%，全球PCB制造将继续向大陆转移，中国大陆PCB产值占全球比重将继续提高。

随着电子信息产业的升级转型、智能制造的全面推进、5G商业化等，PCB行业的发展充满机遇和挑战，公司将通过强化组织能力建设、打造优秀技术团队、提升自主研发、升级智能制造、创新精益管理、积极开拓市场等措施，强化企业的综合竞争力，逐步提高公司的市场占有率。公司2019年将重点开展以下工作：

（一）以客户为中心、强练内功，赢得更多战略盟友

虽然全球PCB制造持续向中国大陆转移、行业集中度不断提升，但宏观经济面临下行压力、下游市场竞争趋烈、国际贸易等不确定性因素增加，2019年必将是挑战和机遇并存的一年。面临严峻的挑战和风险，公司务必保持敬畏心，锻造强健的“体质”，才能继续创造辉煌。在市场国际化的进程中，只有具备品质稳定、交付及时、技术扎实等优势才能获得客户的长久信赖，公司将强化“以客户为中心”的理念，以满足客户要求为基本，不断弥补短板，提高综合竞争力，积极响应客户需求、及时为客户创造价值，以实现与更多优质客户的共进共荣。

（二）强化人力资源管理和组织能力建设，打造钻石般的团队

实现公司规模稳步增长、公司效益的不断提升，管理清晰、职责明确、有活力的组织是关键。公司在建立健全人力资源管理制度、推进公司职位体系建设、中层管理干部培育及讲师队伍建设方面初有成效，需要进一步建立发现人才、培养人才、留住人才的机制。通过建立价值评估体系，强化组织能力建设，制定符合公司实际的人才价值评估标准和方法，准确发现人才、合理价值分配，让奋斗者主动向公司靠拢，如泉赴壑，“人才洼地”才能是企业发展的不竭动力。

（三）强化技术创新、储备高端产品制造能力

技术创新是技术密集型制造企业的生命力，技术水平的高度决定着企业未来能走多远。技术创新是为客户提供更优质的产品和服务，从而吸引更多优质客户，以占据更多的市场份额、打破企业发展的天花板、增强抵御经济周期的波动的能力。

公司具备多种印制线路板产品的制造能力。公司RPCB产品可以提供高多层板、高频高速板应用于消费电子、通讯设备、汽车电子、光电市场、工业控制、5G基站等领域；FPC可以提供应用于模组、手机终端、指纹识别、车载、新能源、天线模组、无线充电等产品；同时公司可以生产RPCB与FPC相结合的刚挠结合板。公司以客户为中心，大量开展技术创新活动，敢于对现有的制造能力提出挑战，配合客户研制新产品，成就客户也提高自己的能力。同时结合市场的发展趋势，积极自主研发，提前储备新技术，以迎接技术红利时代。

（四）持续推进“三化”建设工作，强化智能制造

自动化、信息化和智能化是现代制造业升级发展的必经之路，这个趋势和发展方向是确定的。设备的自动化是智能工厂的基础、管理的信息化是驾驭智能工厂的方法，二者结合才能真正发挥智能工厂的最大效益。公司以江西二期工厂为新战场，提高智能制造的软实力，成立自动化、信息化及智能化委员会，即“三化委员会”，旨在切实推动整个公司的自动化、信息化、智能化水平提升，为公司将来扩产的新工厂夯实更先进的基础，增强公司未来的核心竞争力。公司在三化工作上，将逐步建立完善的机制和体系，敢于思考、充分发挥主观能动性，积极创新、严谨实施，科学管理、认真论证，确保企业投资价值及投资回报率。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，2019年，公司管理层将在董事会的带领下，继续以舍我其谁的使命感、不进则退的危机感、时不我待的紧迫感、勇于担当的责任感开展各项工作。艰苦奋斗、凝心聚力，在攻坚战场上做出更大努力和贡献，为成为全球最可信赖的电子电路制造商而不懈奋斗！

报告人：刘绍柏

2018年3月29日